

URZĄD PATENTOWY w WARSZAWIE OPIS PATENTOWY

co gj 7/02

Nr 29841

Kl. 22 i, 2

Th. Goldschmidt A.-G., Essen

Błona klejąca

Zgłoszono 9 sierpnia 1938

Udzielono 6 czerwca 1941

Pierwszeństwo: 14 września 1937 (Niemcy)

Do sklejania fornierów drewnianych w celu wytwarzania dykty stosuje się błony klejące z porowatego nośnika, przesyconego np. kleiwem z żywicy sztucznej; błony te kładzie się między obiema powierzchniami sklejanymi, a następnie powierzchnie te dociska się do siebie stosując jednocześnie ciśnienie i ogrzewanie. Początkowo błona mięknie ponownie, a następnie przechodzi w charakteryzujący żywice sztuczne stały stan końcowy, w którym nierozłącznie łączy ze sobą obie powierzchnie.

W pewnych przypadkach przy wytwarzaniu dykty i innych produktów warstwowych między warstwy wstawiane są odpowiednie wzmocnienia metalowe w postaci np. siatek lub tkanin drucianych, blach podziurkowanych. Wkładkę taką nakłada

się na żądane miejsce powierzchni pokrytej kleiwem tak, żeby była ona dobrze połączona w kleiwie, po czym na wkładkę nakłada się tę część, która ma być połączona z częścią dolną. Połączenie między poszczególnymi częściami przeprowadza się przez zastosowanie ciśnienia i ogrzewania. Ten sposób umieszczania wkładki metalowej w spoiwie klejowym jest jednak nieco kłopotliwy. O wiele prostsze jest użycie błony klejącej, która jest zaopatrzona w nośnik, składający się bezpośrednio z siatki lub tkaniny drucianej, blachy podziurkowanej lub materiału podobnego. Tego rodzaju błona klejąca stanowi przedmiot wynalazku niniejszego. Kleiwo przenika przez otwórki nośnika i przykrywa je po obydwóch stronach tak, że obie te części skła-

dowe, to jest kleiwo i nośnik tworzą produkt jednolity w postaci błony. Można tu zastosować wszelkiego rodzaju kleiwo nadające się do danego celu. Do kleiwa można również dodawać sproszkowanych lub włóknistych substancji wypełniających w celu zwiększenia jego przyczepności względem nośnika.

Pokrywanie nośnika metalowego kleiwem może być uskuteczniane w różny sposób.

Nośnik metalowy można np. stale odwijać z krawędzi i przeprowadzać przez każdą wypełnioną kleiwem. Kleiwo to przyczepia się wtedy do nośnika i jest prowadzone wraz z nim przez kanał suszący, w którym odbywa się wysuszanie kleiwa na nośniku. Po opuszczeniu kanału suszącego gotową błonę klejącą albo nawija się, albo też rozcina na płyty przygotowując ją do wysyłki.

Dla zapobieżenia odciekaniu kleiwa po drodze od kadzi do komory suszącej obie strony wypełnionego nośnika można pokryć pasmami materiału włóknistego, np. cienkim papierem jedwabnym, który jest tak porowaty, że dobrze przesysa się kleiwem i następnie nie przeszkadza przebiegowi sklejan. Te przykrycia z materiałów włóknistych wraz z kleiwem na nośniku zostają w kanale suszącym następnie silnie wysuszone, a następnie zapobiegają wykruśzaniu się kleiwa.

Inny sposób polega na tym, że kleiwem w suchym stanie, zmieszanym ewentualnie z substancjami wypełniającymi, pokrywa

się nośnik metalowy i następnie łączy z tym nośnikiem przy zastosowaniu ciśnienia i ogrzewania poniżej temperatury twardnienia, przy czym kleiwo znowu nieco mięknie.

Z a s t r z e ż e n i a p a t e n t o w e .

1. Błona klejąca, składająca się z nośnika wypełnionego kleiwem, znamienna tym, że nośnik stanowi siatka druciana, tkanina druciana, blacha podziurkowana lub podobny produkt metalowy, zaopatrzone w otwory.

2. Błona według zastrz. 1, znamienna tym, że kleiwo wypełniające nośnik jest zmieszane ze sproszkowanymi lub włóknistymi substancjami wypełniającymi w celu zwiększenia jego przyczepności w stosunku do nośnika.

3. Sposób wytwarzania błony klejącej według zastrz. 1 — 2, znamienny tym, że powierzchnie wypełnionego nośnika pokrywa się porowatą substancją włóknistą w celu zapobieżenia odciekaniu względnie odkruszaniu się kleiwa.

4. Sposób wytwarzania błony klejącej według zastrz. 1 — 2, znamienny tym, że kleiwo rozsypuje się na sucho na nośniku i łączy z nim przy zastosowaniu ciśnienia i ogrzewania poniżej temperatury twardnienia.

T h. G o l d s c h m i d t A. - G.

Zastępca: inż. J. Wyganowski
rzecznik patentowy